

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 19 年 11 月 22 日 (2007.11.22)

【公開番号】特開 2001-172090 (P2001-172090A)  
 【公開日】平成 13 年 6 月 26 日 (2001.6.26)  
 【出願番号】特願 2000-309392 (P2000-309392)  
 【国際特許分類】

**C 0 4 B 38/00 (2006.01)**

**C 0 4 B 41/85 (2006.01)**

**C 0 4 B 35/00 (2006.01)**

【F I】

C 0 4 B 38/00 3 0 3 Z

C 0 4 B 41/85 C

C 0 4 B 35/00 H

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 10 月 10 日 (2007.10.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】平均径が 5  $\mu$ m 以下の独立した気孔を有するセラミックスであって、(1) 該気孔の気孔率が 7 % 以下であり、(2) 比剛性 (ヤング率 (GPa) / 密度 (g / cm<sup>3</sup>)) が 30 以上であり、(3) JIS R 1618 による、20 ~ 30 における熱膨張係数の絶対値が  $3 \times 10^{-7}$  / K 以下であるセラミックス。

【請求項 2】JIS R 1602 によるヤング率が 100 GPa 以上である請求項 1 記載のセラミックス。

【請求項 3】スボジューメン、ユークリプタイト、リン酸ジルコニル又はチタン酸アルミニウムを主成分とし、窒化ケイ素、炭化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素ウイスカー、酸化錫、炭素、及びチタン酸鉄からなる群から選ばれる少なくとも 1 種を副成分として含み、該副成分の含有量が 1 ~ 44 重量 % であるセラミックス。

【請求項 4】請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のセラミックスを基材に使用してなる半導体製造装置用部材。

【請求項 5】前記基材の表面に導電性被膜が形成されてなる請求項 4 記載の半導体製造装置用部材。

【請求項 6】前記導電性被膜が炭化ケイ素、炭化チタン、炭素、窒化チタン及び窒化アルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも 1 種からなるものである請求項 5 記載の半導体製造装置用部材。

【請求項 7】前記導電性被膜が窒化アルミニウム及び窒化チタンからなるものである請求項 6 記載の半導体製造装置用部材。